

ぐんま Tech EXPO 2025 出展企業PRシート

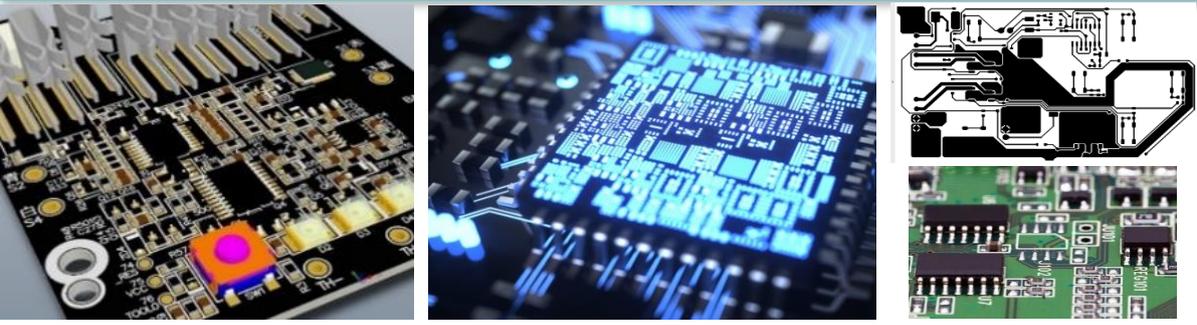
ブースNo.	出展分野	企業名
G-5	先端テクノロジー・AI	伊原電子工業株式会社

ポイント

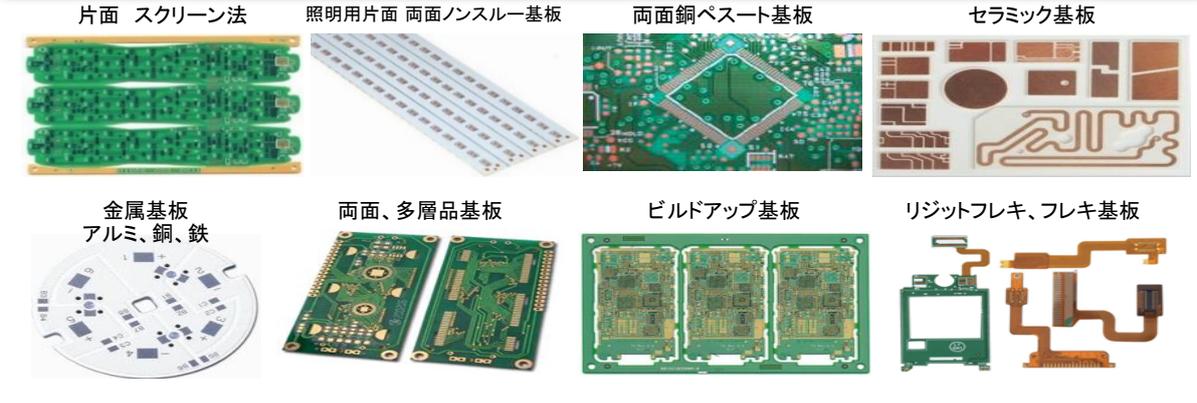
回路設計・基板設計～基板製作・実装

基板の設計開発から試作・実装まで量産化して製品をご提供！

- 回路設計** マイコンを応用した製品の開発提案と回路図のデータ作成をいたします。
- 基板設計** 基板設計3Dデータの提供、各種パターンやガーバーからの作成等対応いたします。
- 基板製作** ニーズに応じて各種基板のローコスト・短納期に対応いたします。(試作/量産)
- 基板実装** 部品調達から量産化まで一貫した体制で短納期・高品質な製品を製造いたします。



※基板は片面、両面、高多層、金属基板、ビルドアップ、フレキなど供給可能！
(試作・小ロット量産対応)



■企業情報

本社	群馬県甘楽郡甘楽郡南牧村磐戸140
県内拠点	群馬県甘楽郡甘楽郡甘楽町福島90-1
海外拠点	中国(深圳・提携工場)
資本金	1,000万円
従業員数	社員33名(他に嘱託・パート)他関連会社
主な資格	経営力向上計画認定(経済産業省)
主な取引先	日本ボデーパーツ工業(株)、IPF(株)、(株)MonotaRO タカラスタンダード(株)、Amazon、他100社
事業内容	各種スイッチ・電子ブザー・基板ASSY品 電子部品・ハーネス、設計開発～量産化 OEM製品受託生産、電子部品の販売
担当者	代表取締役 伊原 智雄
TEL	0274-74-3141
E-mail	t-ihara@idk-inc.co.jp
会社HP	http://www.idk-inc.co.jp

■設計開発・生産体制(企業情報)

対応	企業情報
【企画・開発・販売】 製品化の企画・提案 組立・検査・販売	伊原電子工業株式会社  TEL: 0274-74-3141
【回路・基板設計】 プリント配線板の設計 半導体パッケージ基板設計	有限会社 エクサス  伊勢崎市宗高町88-5 TEL: 0270-50-7320
【基板製作】 プリント基板の試作・量産 片面・両面・多層基板	SPC (HK) CO.,LTD (香港)  SPC (HK) 日本駐在所 伊勢崎市宗高町88-5
SMT実装、DIP実装	実装工場(協会会社含む5工場)

■主要素材・製品例

加工可能な素材や材料・主な製品例	
FR-4、アルミ (片面・両面・多層)	LED関連、自動車用品 (EFI、PW、ABS等) 半導体パッケージ基板 (PGA、BGA、CSP)
フレキ	医療機器用
金属(銅など各種)	各種の産業機器用